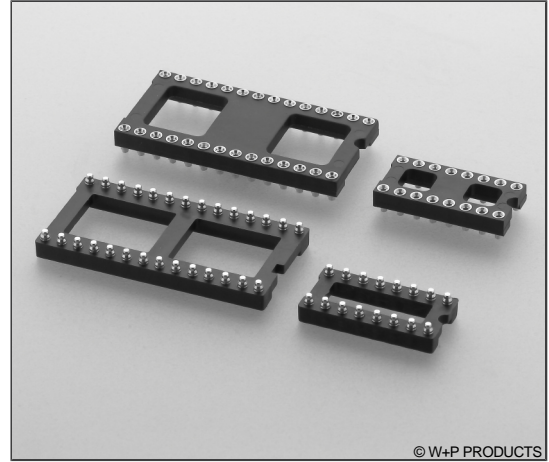


## SMT IC-Fassungen RM 2,54mm – Präzisionskontakte schwimmend gelagert SMT IC-Sockets 2.54mm Pitch – Floating Screw Machined Contacts

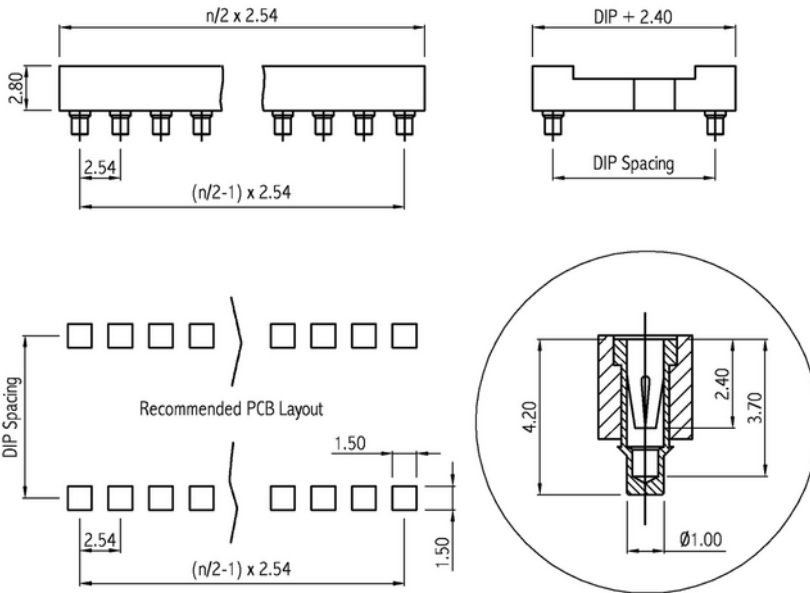
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer <i>Sleeve: screw machined brass</i> <i>Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (2 ... 3µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (2 ... 3µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV <sub>RMS</sub>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100V <sub>RMS</sub> / 150V <sub>DC</sub>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +125°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

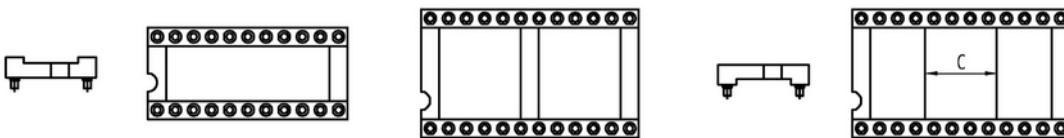
Für Rundstifte Ø0,40-0,56mm  
oder Vierkantstifte 0,25x0,45mm.  
For Ø0.40-0.56mm round pins  
or 0.25x0.45mm rectangular pins.



Machine Assembly Type		
n	DIP Spacing	Dimension C
08	3 (7,62)	--
10	2 (5,08)	--
16	3 (7,62)	5,30
24	3 (7,62)	8,30
28	6 (15,24)	10,00
32	6 (15,24)	10,00
40	6 (15,24)	10,00

### Manual Assembly

### Machine Assembly



Series	Contacts*	DIP Spacing*	Assembly*	Sleeve Plating	Clip Plating*	Packing
<b>3230</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>00</b>	<b>ST</b>
	10 =====>	2 5,08mm	1 Für Handbestückung For manual assembly	50 Verzinkt Tin plated	00 Vergoldet Gold plated	ST Verpackt in Stangen Packed in tubes
	04-10/14-24/28 =====>	3 7,62mm	2 Für Automatenbestückung (s. Tabelle)		10 0,25µm Gold (Option) 0,25µm gold plated (Option)	
	22/24/28/32 =====>	4 10,16mm				
	24/28/32/36/ 40/42/48 ==>	6 15,24mm	For machine assembly (s. table)			

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

